

办理结果：采纳解决

公开属性：主动公开·全文

上海市普陀区科学技术委员会文件

普科委〔2024〕22号

对区政协十五届三次会议 第153100号提案的答复

吴景瀚、杨大耀委员：

您们提出的“关于推进上海普陀与香港技术研发创新合作交流”的提案收悉，区科委会同区投促办，认真进行研究，现将办理情况答复如下：

一、推动沪港两地政产学研合作

近年来，普陀区聚力服务上海“五个中心”建设，加快实施创新驱动发展战略，全力构建“中华武数”科创布局，“中”即中以（上海）创新园，“华”即上海清华国际创新中心，“武”即武宁创新共同体，“数”即海纳小镇数字化转型示范区。其中，“武”集聚了华东师大、同济大学（医学院）2家985高校，电科所、华东电力、测绘院等16家科研院所，机器人研发与转

化、工业控制系统安全创新等79个国家、市、区功能性平台，以及区内近千家科技企业的创新资源，是普陀服务辐射上海科技创新中心和沿沪宁产业创新带建设的“桥头堡”。

自2023年4月19日成立以来，武宁创新共同体通过成员单位间的协同创新攻关，推动政产学研深度融合。一是打造“科创集市”，提供集成服务。企业带着自己的需求来“赶集”，在“集市”上可以项目路演、成果展示、投融资对接、咨询人才落地政策等。二是搭建开放平台，精准赋能科创。成立“百大平台”联盟，集聚国家级、市级、区级近百个科技研发平台、工程研究中心、企业技术中心、金融服务平台，提供专业化、“组团式”服务，降低创新的门槛和成本。三是深度供需对接，加速成果转化。举办“院所开放日”活动，量身定制上下游资源和生态伙伴走进院所，对接技术需求和解决方案，探索“企业出题、院所答题”创新机制。

针对委员们提出的“建立沪港两地科技创新合作联盟”的建议。近期，我区将发布《普陀区关于推进武宁创新共同体建设支持创新主体发展的实施意见（试行）》，专项政策涵盖了科技创新全要素，通过营造高质量创新创业生态全方位支持初创团队、服务机构、赛事活动，鼓励协同创新攻关，助力初创型企业培育和“核爆点”产业打造。我们诚挚欢迎香港高校、院所、企业等创新主体加入武宁创新共同体，我区将依托共同体专项政策进一步促进两地之间的协同创新，推动两地产学研

合作项目在普陀转化落地。

二、促进沪港两地科技园区交流

近年来，普陀区围绕智能软件、研发服务、科技金融、生命健康、网络安全、数字广告等重点产业，推进建设符合各类产业导向的园区载体，如上海天地软件园聚焦大数据及互联网+、动漫游戏、智能制造及机器人等领域，长风科技园聚焦生物医药、新材料、安全环保等领域，武宁科技园聚焦智慧交通、智慧能源、检测认证等领域，数字广告产业园聚焦广告业数字化转型新赛道。同时，依托华东师大、同济大学的品牌、人才、科研、文化优势，建设国家大学科技园，为创业人才提供全过程全方位服务。

针对委员们提出的“推动沪港两地科技园区合作共赢”建议。我区正在试点打造武宁创新共同体实体地标——“创新里”科创产业空间，通过共同体专项政策给予最高两年免租期，吸引硬科技企业和未来产业在“创新里”超前发现、超前布局、超前孵化。下一步，我区将以“创新里”为契机加大同香港相关园区、机构平台的合作，扩大武宁创新共同体品牌知名度，助力两地优质科技企业、人才的合作共赢。

三、注入沪港两地合作发展活力

随着沪港两地交流日趋频繁，我区逐步引进了一批优秀港资企业，截止目前全区入驻港资企业超400家，共同助力普陀经济和社会高质量发展。针对委员们提出的“在港设立招商引资

窗口”建议。下一步，我区将做好以下三方面工作：一是加强宣传推介，实现共赢发展。积极参加香港企业家各类商会活动，深化与爱国爱港工商界社团的交流沟通；主动邀请香港企业家、香港企业在沪机构等来参与普陀区营商环境大会等活动；依托相关平台和载体，做好普陀宣传推介工作，扩大普陀在港甚至海外的知名度和美誉度，推动沪港两地经贸和招商引资务实合作。二是推动友好交流，深化务实合作。走访香港相关科技产业园区和企业，学习考察香港创新创业相关情况，寻求沪港两地经贸、科技等领域的合作机遇；拜访长期以来与我区保持密切联系的香港工商界代表人士，特别是高校人士、科研机构人员、企业家等，听取其对普陀发展的意见建议；拜访香港相关商协会，探索建立长效化合作机制。三是提供常态服务，助力资源集聚。目前我区在广东深圳设有“投资上海·普陀粤港澳大湾区服务点”，面向大湾区企业提供精准、周到的咨询服务，帮助企业 and 人才了解投资政策、把握投资机遇。下一步我区将依托在港友好社团、普陀企业在港机构，探索设立在港常态化招商引资工作站的可能性，以便更多香港企业和人才及时咨询普陀相关招商政策。

上海市普陀区科学技术委员会

2024年4月19日

联系人姓名：施浥淳

联系电话：52564588-7165

联系地址：大渡河路1668号2号楼

邮政编码：200333

上海市普陀区科学技术委员会办公室

2024年5月23日印发